8D分析改善报告

W/DP QA-Q5005-02

NO.20171026001

8D Analysis Improvement Report

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品型号 Product Model**  | O11F-Q311-38.88MHz | **开始时间 Start Date** | 2017-11-05 |
| **来源 Source**  | G024 | **报告时间** **Report Date** | 2017-11-15 |
| **组长Team Leader** | 林小荷 | **组员 Members** | 陈京武，李华盛，周文，李洪润李志豪，程国华，王春明 |
| **问题描述 Problem description：** |
| **客户投诉&抱怨以及反馈** | **数量Qty** | **哪里 here** | **时间Date** |
| 客户反馈我司样品出货产品O11F-Q311-38.88MHz无输出。 | 1 | G024 | 2017-10-26 |
| **不良原因分析Failure Analysis Result：** |
| **1、外观检查**产品.bmp图1 产品外观检测图外观检查：产品外壳未发现明显脏污、刮伤、撞痕等外观不良，未发现明显的不良情况。焊盘上锡，证明产品被使用过，但中间有一个管脚未上锡，说明客户使用该产品时可能为手工焊接。扫描条码确认条码序列号为20160128029。**2、性能复测**对该产品进行性能复测，详细情况见表1所示：表1 性能复测结果复测结果.bmp结论：从表1的性能复测结果可以看出，工作电流和启动电流正常，产品表现为无输出。**3、出货数据记录检查**翻阅该产品出厂时的各项性能检测数据记录，详细见表2所示：表2 出厂性能测试记录出货数据.bmp结论：各项性能测试结果均满足规格书要求，出厂时是合格产品。 |
| **根本原因分析** |
| **针对无输出的异常的情况，对产品进行拆壳分析：**拆壳后，对产品进行焊点的检查，经检查发现底板上IC的引脚与焊盘脱离，如下图所示： 底板IC起翘.bmp图2 产品焊盘检测图由此可以推测可能是由于IC的脱离导致产品无输出，拆开上板后，确定该IC 为输出BUFF,将IC重新焊接至下板，复测其基本性能，发现产品均满足规格书要求如表3所示，由此可以确定产品的无输出是由于IC有引脚脱离线路板所致。重新焊回后复测.bmp表3 重新焊接IC后重新复测记录 经出货记录前数据追溯查询，所有测试数据都正常，而脱离IC为输出BUFF,故排除出厂前该IC 存在脱离现象，通过客退的产品焊盘分析，焊盘未上锡，客户可能采用的手工焊接，因此导致IC与焊盘脱离的原因可能为由于焊接时间过长，温度过高并有抖动和振动的现象存在，导致IC受应力与焊盘分离。 |
| **围堵计划/ 临时措施****Containment Plan ( Temporary Action )** | 谁 Who | 实施时间Implement Date | 实施验证Verification | 谁 Who | 验证时间Verificate Date |
| 请客户确认产品焊接的方法与条件，焊接时是否有异常情况发生。 |  |  |  |  |  |
| **长期措施****Permanent Corrective Actions ( Long Term )** | Owner负责人 | 时间 Date | 状态Status | Verification验证 | 时间 Date |
| 建议焊接产品使用回流焊，或参考IPC-A-160的要求进行产品的焊接 |  |  |  |  |  |
| **标准化/防止再发生** **Standardization / Prevention of Recurrence** | 谁 Who | 时间 Date |
| NA |  |  |
| 祝贺团队 Congratulation Your Team  | 谁 Who | 时间Date |
| 陈京武，李华盛，周文，李志豪，程国华，王春明 | 林小荷 | 2017.11.16 |
|  |  |  |  |  |  |

Prepared 草拟：林小荷 Reviewed 审核：周文 Approved批准： 陈京武